天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出 席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事8人)。

会议由董事长崔学峰召集并主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")等有关法律、 法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一) 审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司编制了《天津金海通半导体设备股份 有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天 津金海通半导体设备股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

(二) 审议通过了《关于<2025 年 1-9 月计提信用及资产减值准备>的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实、准确、公允地反 映公司财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内

各公司所属存在减值迹象的资产进行了减值测试,对合并报表范围内可能发生减值 损失的有关资产计提相应减值准备。公司本次计提各项信用及资产减值准备合计 26,152,694.35 元。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票;回避 0票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于2025年1-9月计提信用及资产减值准备的公告》(公告编号: 2025-056)。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司 董事会 2025年10月29日